证券代码：688206　　证券简称：概伦电子

上海概伦电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

2026-01

投资者关系活动类别	☑ 特定对象调研　☑ 分析师会议 ☐ 媒体采访　☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☐ 路演活动 ☑ 现场参观　☐ 路演活动 ☐ 其他　（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	安联基金、富国基金、光大证券、国金证券、国信中数投资、宏利基金、华创证券、华源证券、汇正投资、南华基金、润义投资、山西证券资管、辛格资本、易米基金、一久基金、中庚基金、中信建投基金、中银基金、中银资管
会议时间	2026 年 11 月 02 日-2026 年 11 月 05 日
会议地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	**1. 根据已披露的公司《2026 年第三季度报告》，请详述公司收入结构变化情况。** **答：**2026 年第三季度，公司完成了对锐成芯微 100%股权及纳能微 45.64%股权事项的收购，标的资产过户及工商变更登记手续均已办理完毕，并向向建军等交易对方发行 67,456,798 股新增股份完成登记。公司同步完成配套融资环节，以 38.92 元/股的发行价格发行 26,978,417 股股份，募集资金总额约 10.50 亿元，配套融资新增股份于 2026 年 9 月 3 日完成登记，公司总股本增至 531,014,050 股。

	因锐成芯微、纳能微纳入合并报表范围，基于行业惯例及各业务之间的协同性，公司对主营业务分类进行了重新调整：新增 IP 授权业务和芯片定制业务，并将原技术开发解决方案业务中的 IP 授权业务调整进入 IP 授权业务；原技术开发解决方案业务更名为 EDA 技术开发解决方案业务。 2026 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 41,754.16 万元，同比增长 32.93%。其中，EDA 软件授权业务收入 23,255.43 万元，占比 55.70%；IP 授权业务收入 6,039.48 万元，占比 14.46%；EDA 技术开发解决方案业务收入 5,874.64 万元，占比 14.07%；半导体器件特性测试系统业务收入 3,872.55 万元，占比 9.27%；芯片定制业务收入 2,712.06 万元，占比 6.50%。 **2. 公司近期发布汉擎原生模拟 EDA 平台，请介绍该平台及其现阶段对公司产品布局、对产业发展的意义。** **答：**公司持续推进 NanoDesigner 一体化定制芯片与 IP 设计平台建设，围绕原理图设计、电路仿真、版图设计及验证等关键环节，加强工具集成与流程衔接，为客户提供更加完整的定制芯片与半导体知识产权（IP）开发环境，提升不同设计环节之间的数据复用与协同效率。在汉擎开放生态建设中，NanoDesigner 作为唯一原生支持汉擎数据库和汉擎工艺设计套件（hPDK）的设计平台，承载 hPDK 及支持汉擎接口的第三方 EDA 工具，平台采用 Python 原生架构，为自动化设计及 AI 能力接入提供支持，已完成 28nm 工艺流片验证，并持续推进先进工艺流片验证，成为汉擎生态建设与应用落地的重要载体。依托这一平台定位，公司携手产业伙伴推进统一开放的工艺数据底座建设，加强国产工具、工艺数据及设计流程的协同，提升对成熟工艺差异化应用和先进工艺研发的支撑能力。 国内 EDA 产业发展存在着汇聚全行业力量、降低创新门槛、分摊研发成本、压缩迭代周期、抢占技术时间窗口的诉求，打破工具孤岛、数据孤岛、生态孤岛，构建一套可输入、可输出、可

	互通、可协同的统一底层标准底座成为产业整体提速发展的必然要求。汉擎原生模拟 EDA 平台的发布，标志着国产模拟 EDA 拥有了自主可控、统一开放、可智能化演进的国家级底层平台。以汉擎 PDK 为统一底座、以 NanoDesigner 为核心载体、以全行业协同共建为路径，国产 EDA 正从单点突破走向体系成型、从工具应用走向生态自立，为中国集成电路产业高质量发展筑牢核心底座。 **3. 公司联合鸿芯微纳、启芯领航和玖熠科技共建数字 EDA 全流程，请介绍一下各方将如何协作分工，后续推进要点是什么？** **答：**各方围绕数字芯片研发形成互补：启芯领航提供硬件仿真、原型验证等前端验证能力，玖熠科技提供可测试性设计能力，鸿芯微纳提供布局布线等后端物理实现能力；概伦电子则依托器件建模、电路仿真、标准单元库及存储器基础库等能力，为数字设计提供工艺基础资源和分析验证支持。通过生态合作，各方共同推进面向国产工艺的数字设计工具链建设。 后续重点将围绕真实客户项目，推进工具接口、工艺模型、基础库及设计流程之间的适配与联合验证。公司将积极推动晶圆厂、设计企业及更多生态伙伴参与，以客户需求牵引研发迭代，逐步提升流程完整性、工程适用性及交付能力，为算力与 AI、高端存储等芯片研发提供支持。 **4. 公司发布 PrimAI 战略，具体有哪些布局？AI 智能体与现有 EDA 工具是什么关系？** **答：**公司 PrimAI 战略包括 AI in EDA 工具层、Agentic EDA 流程层、Intelligent EDA 生态层三个层次：工具层利用 AI 提升核心算法和工具效率；流程层通过专业智能体调用工具、衔接研发任务，提升设计流程效率；生态层联动晶圆厂、IP 企业及大模型企业，共同探索工程能力与资源协同。现阶段，公司重点打造 Prima Agent Union 智能联合工程平台，布局模拟设计、数字验证、标准单元库生成及先进封装等场景的专业智能体。

	公司认为，随着国产工艺分叉，AI 进一步放大机遇，带来市场扩容、赛道增加、时间窗口拓宽等发展红利。智能体可以承接任务组织、工具调用、重复调试和结果分析等工作，但关键计算与验证仍需依托可信的 EDA 工具。公司将以具体应用场景为切入点，持续探索跨工具、多智能体协同，将 AI 能力逐步融入客户研发流程。 **5. 随着国产工艺发展和高端芯片需求增加，公司如何提升先进工艺支持能力，并形成新的增长空间？** **答：**先进工艺的发展对器件模型、电路仿真、基础 IP 和设计流程提出了更高要求。随着国内工艺路线形成差异化，客户需要更加贴合本土工艺特点的工具与 IP 支持。公司将持续发挥设计与工艺协同优化（DTCO）优势，围绕工艺开发和芯片设计需求，推动模型、PDK、基础库及 EDA 工具协同，帮助客户在性能、功耗及面积（PPA）、可靠性和研发效率等方面开展优化。 在具体产品上，公司已在先进工艺下完成 AutoCell 版图快速生成实测验证，并推动其与 NanoCell、NanoRam 及 NanoLV 协同，完善版图自动化、库特征化和质量校验能力。公司将结合实际客户项目持续迭代，将先进工艺支持能力转化为工具授权、IP 授权及技术服务机会，同时兼顾成熟工艺的差异化需求，拓展应用驱动的全流程解决方案。
日期	2026 年 11 月 6 日